販売用資料
2026.10

半導体関連
日本株式戦略ファンド
愛称：半導体ジャパン

追加型投信／国内／株式



ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

◆投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お申込みは

岡三証券

商　　号　岡三証券株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第53号
加　入　協　会　日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会
　　一般社団法人金融先物取引業協会
　　一般社団法人第二種金融商品取引業協会

◆設定・運用は

三井住友トラスト・アセットマネジメント

商　　号　三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第347号
加　入　協　会　一般社団法人資産運用業協会

私たちの生活に欠かせない半導体はあらゆる産業の根幹

半導体は、急速に発展しているデジタル社会の重要基盤であり、デジタル化が加速している今、その重要性はますます高まっています。半導体は、今やあらゆる産業を支える「根幹」といえます。



すべての産業

ITや製造業だけでなく、
サービス業や農業も含めたすべての産業

デジタル産業

クラウドやサイバーセキュリティ、
プラットフォーマーなどのデジタル関連産業

デジタルインフラ

データセンターや5G*、通信機器などのインフラ
*第5世代移動通信システム

半導体

半導体は、身近な家電製品から社会全体を動かすインフラまで幅広い用途で使われており、私たちの日々の生活になくてはならない存在です。



情報端末
・スマートフォン
・タブレット



娯楽機器
・テレビ
・ビデオカメラ
・ゲーム機



家電製品
・エアコン
・洗濯機



PC・OA機器
・パソコン
・プリンター



自動車部品
・自動車

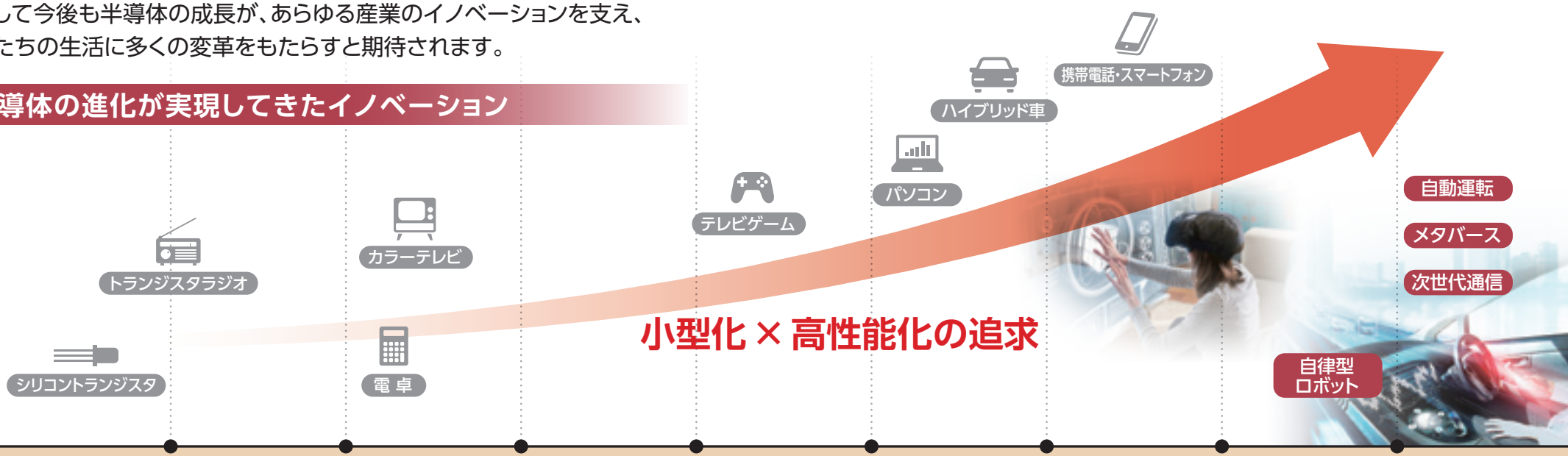


インフラ
・ATM
・電車
・送電網

半導体の進化があらゆる産業のイノベーションを加速させる

これまで半導体の高性能化を背景に、情報処理や通信が高度化したことで、多くのイノベーションが生まれてきました。
そして今後も半導体の成長が、あらゆる産業のイノベーションを支え、
私たちの生活に多くの変革をもたらすと期待されます。

半導体の進化が実現してきたイノベーション

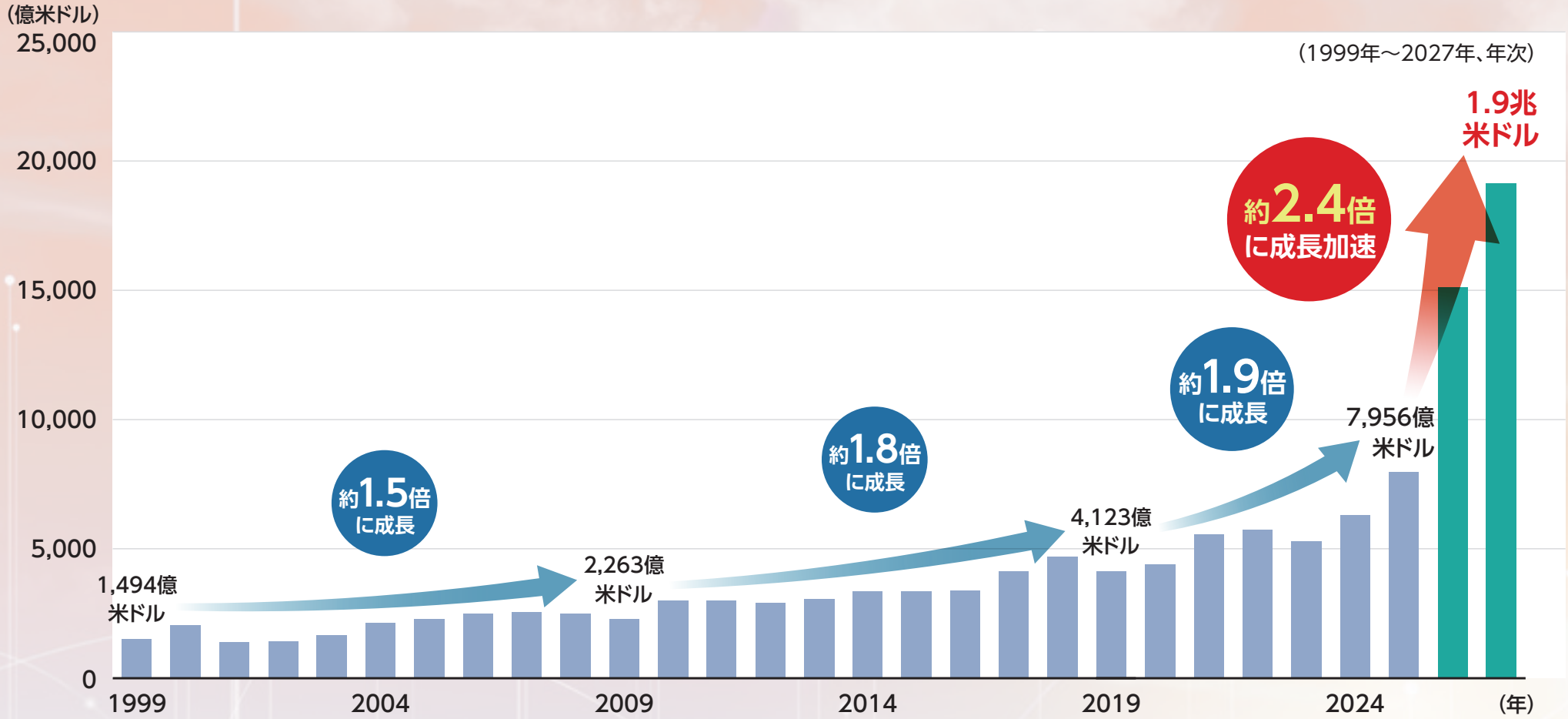


※上記はイメージ図であり、全てを網羅したものではありません。
(出所)各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

半導体産業は新たな成長段階に

半導体産業は、これまで需要の中心だったパソコンやスマートフォンに代わり、今後新たな需要が牽引役となり、成長が加速していくとみられています。新たな成長段階に入る半導体産業は、今後ますます魅力的な投資機会を創出すると期待されます。

世界の半導体市場規模の推移と将来予測



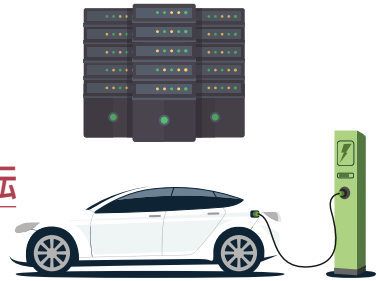
※2026年、2027年はWSTS(世界半導体市場統計)予測値。
(出所)Statista、WSTSのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

新たな成長ドライバーにより半導体市場の成長は加速

パソコン・スマートフォン
を中心とした情報端末

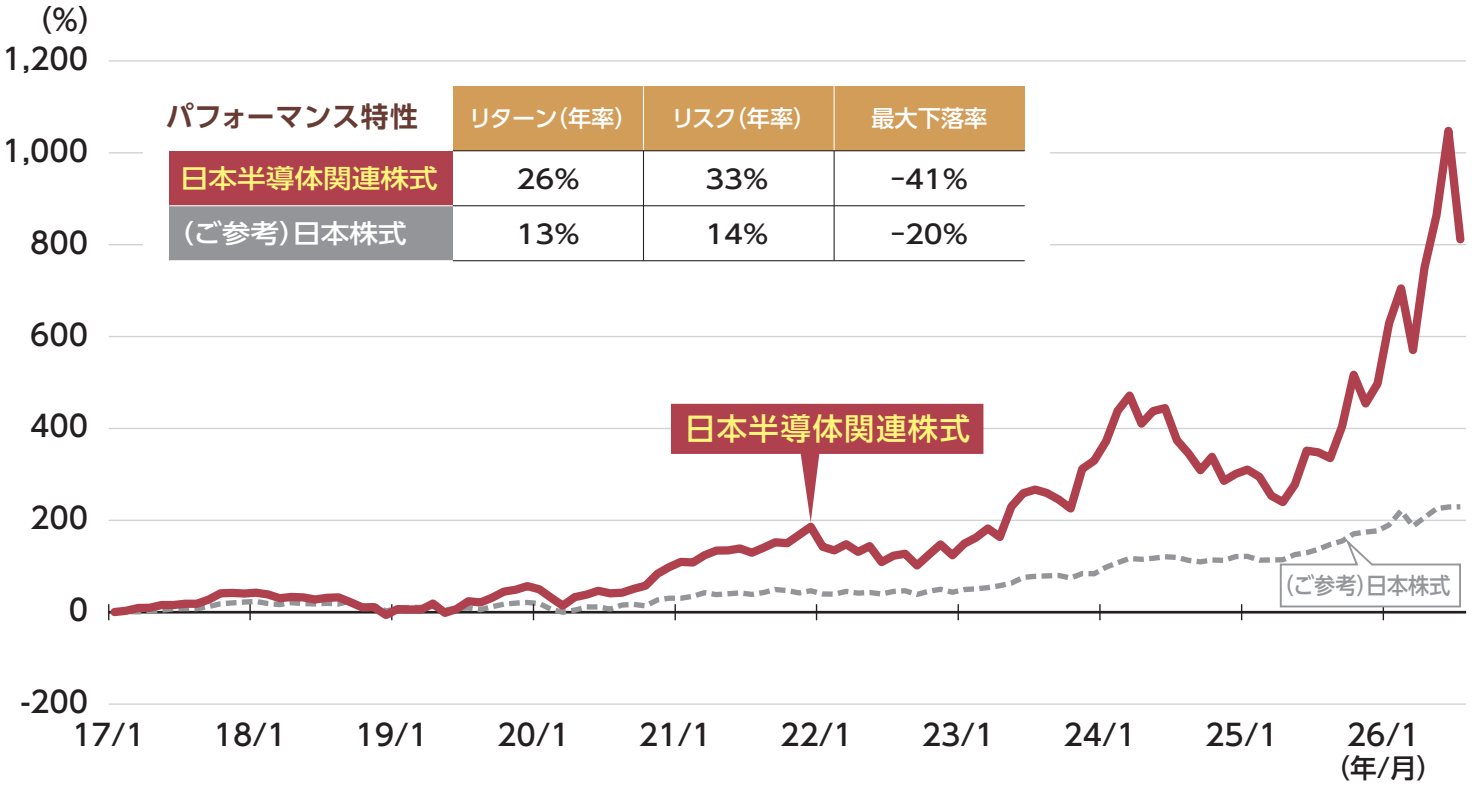


1 デジタルインフラの増強
2 EV（電気自動車）・自動運転
を中心とした新たな需要



※画像はイメージです。

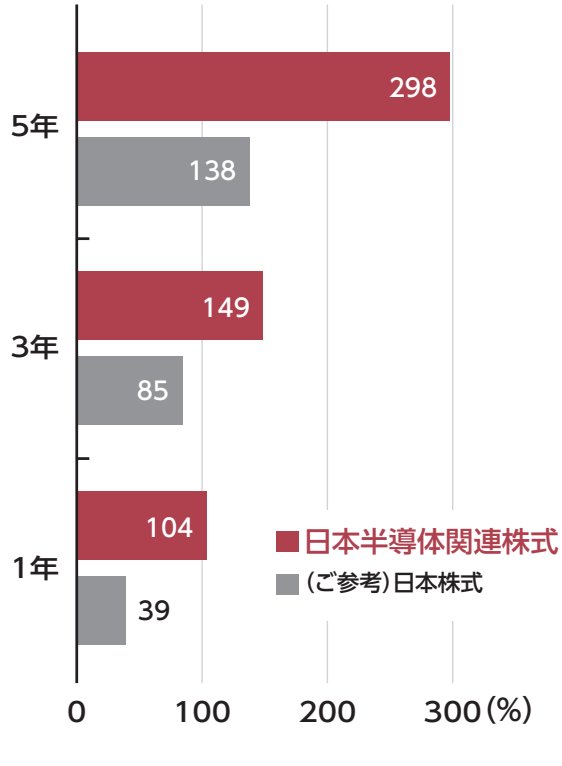
（ご参考）半導体関連株式等の累積収益率の推移 （2017年1月末～2026年7月末、月次）



パフォーマンス特性	リターン（年率）	リスク（年率）	最大下落率
日本半導体関連株式	26%	33%	-41%
（ご参考）日本株式	13%	14%	-20%

期間別騰落率

（2026年7月末現在）



※各資産のリターンとリスク（標準偏差）は、計算期間における各指数の月次騰落率を基に年率換算。最大下落率は、計算期間内における過去の最高値からの下落率で最も大きかった値（各月末値ベース）
※次のインデックス（配当込み）を使用。日本半導体関連株式:ファクトセット日本半導体インデックス、日本株式:TOPIX（東証株価指数）
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

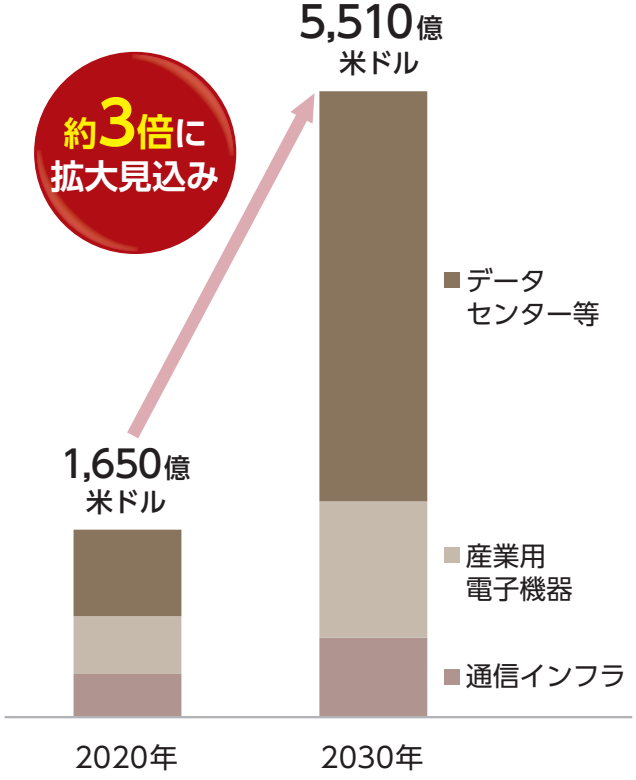
デジタルインフラの増強

Semiconductor

- 社会のデジタル化は、生成AI（人工知能）の本格普及と相乗して今後ますます加速する見通しです。データ通信量が飛躍的に増加し、対応する演算処理への要求が高まるなか、AIデータセンター等のデジタルインフラ向け半導体の需要が急拡大しています。
- 半導体関連企業は、世界的にAIの開発競争が激化するなかで製造能力や設備投資を強化しており、AI半導体市場は今後も拡大が続く見通しです。

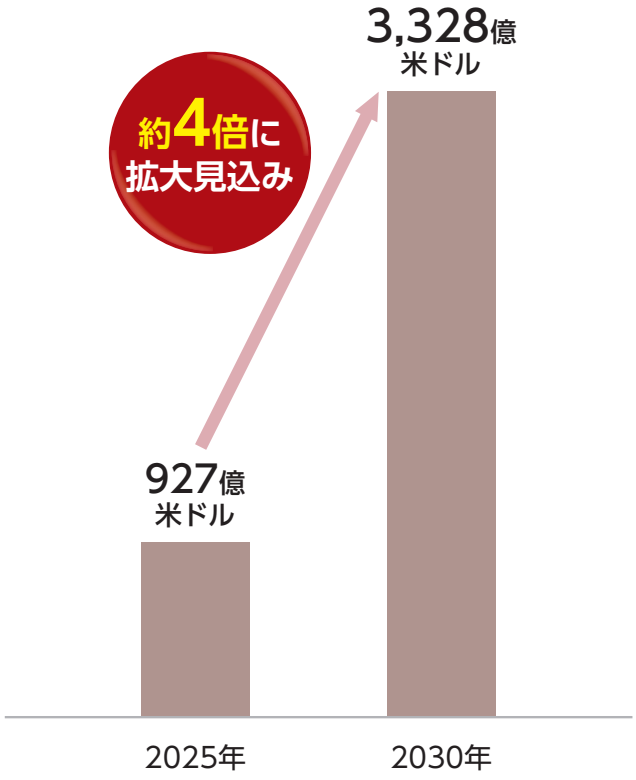
＊IoT（Internet of Things）：モノのインターネット

デジタルインフラ向け半導体市場の将来予測



※2030年はASML予測値
（出所）Statistaのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

AI半導体チップ市場の将来予測



※Statistaの推計値
（出所）Statistaのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

生成AIとは？

- 文章や画像を自動的に作成するAIのことをいいます。



※上記は生成AIアプリのしくみを表したイメージ図です。

自動車の進化

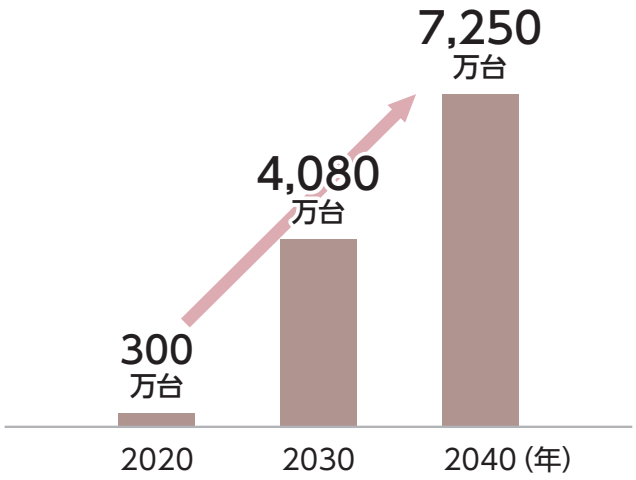
- 脱炭素へのシフトで急速に普及が進むEVでは、内燃エンジン車の約2倍の額の半導体を必要とします。また、欧州等ではEV販売が大きく伸びており、こうした電動化の進展が今後の半導体需要を一段と押し上げていくことが予想されます。
- さらには、実用化が進む自動運転技術においても、より高性能で多くの半導体が必要となることから、車載半導体の需要は今後加速度的に拡大していく見込みです。

電動化の加速 × **自動運転技術の進展** ＝ **車載半導体需要の増加**

世界のEV車の販売台数の将来予測

1台あたり半導体の搭載額



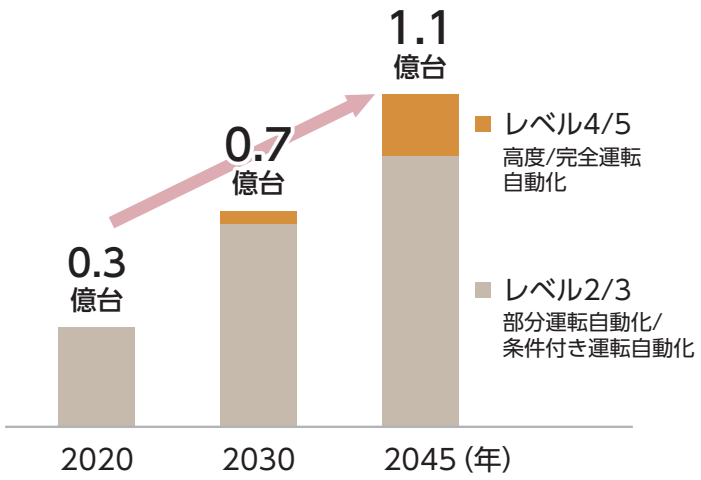


※1台あたり半導体の搭載額は平均値
※2030年、2040年はIEA（国際エネルギー機関）持続可能な開発シナリオの予測値
（出所）以下のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
上部の1台あたり半導体の搭載額:インフィニオン・テクノロジーズIR資料、下部のグラフ:IEA「クリーンエネルギーへの移行における重要な鉱物の役割」

世界の自動運転車の生産台数の将来予測

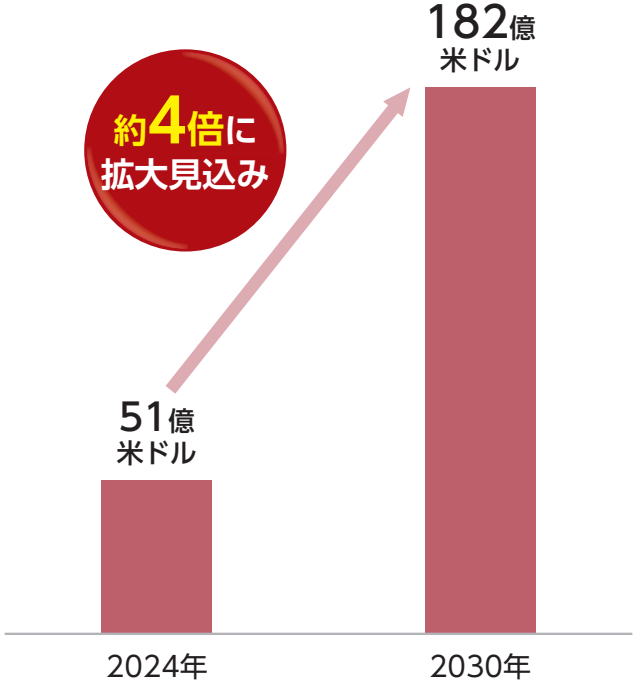
自動運転車における半導体の役割

- 高度な演算処理
- 大容量かつ低遅延な通信機能
- 高精度な認識・判断機能



※2030年、2045年は富士キメラ総研予測値
（出所）富士キメラ総研「2022 自動運転・AIカー市場の将来展望」

先端車載半導体市場の将来予測



※2030年はマッキンゼー・アンド・カンパニー予測値
（出所）Statistaのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

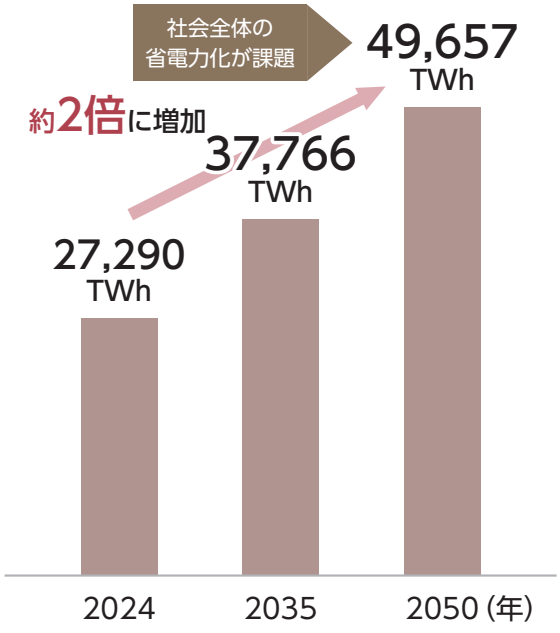
注目のポイント　01

省電力化の観点からも貢献が期待される半導体

■ 社会のデジタル化を背景に今後も消費電力の増加が予想されており、「省電力化」に貢献する半導体技術に注目が集まっています。
■ 特に電力消費を左右するパワー半導体では、大幅な省電力化を実現する次世代型の実用化が進んでおり、今後の成長が期待されます。

電力需要の増加

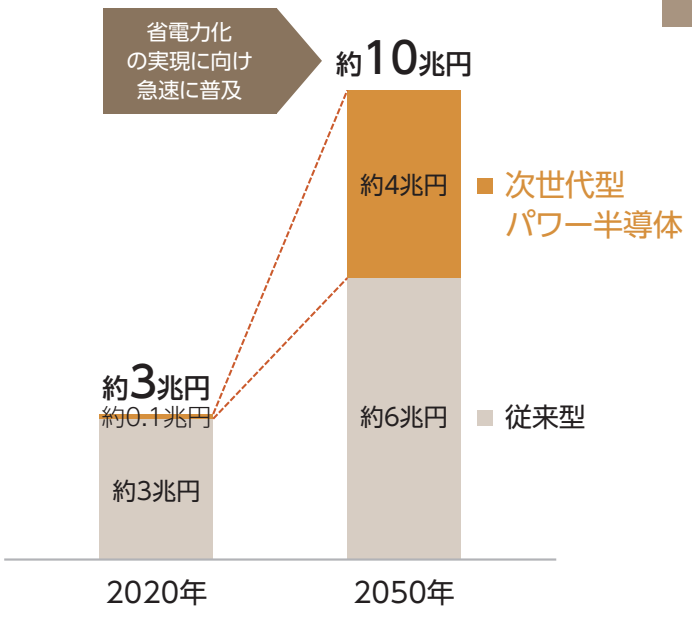
世界の電力需要量の将来予測



※1TWh(テラワット時)=10億kWh(キロワット時)
※2035年、2050年はIEA予測値
※各国の現行政策および公表済みの政策計画を前提に試算
(出所)IEA「世界エネルギー見通し 2025年版」を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

省電力化を背景にパワー半導体需要の増加

パワー半導体市場の将来予測



※2050年は経済産業省予測値
※従来型パワー半導体はSi(シリコン)、次世代型パワー半導体はSiC(炭化ケイ素)、GaN(窒化ガリウム)、Ga2O3(酸化ガリウム)等を使用した半導体
(出所)経済産業省「「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画」を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

パワー半導体とは?

- 電気をモーターや電子部品に適した状態に変換する役割を担い、電気の変換時に発生する損失が少ない特性があります。
- 次世代型のパワー半導体は、電力損失の低減に加えて放熱性を高める構造によって、従来型よりも高電圧・大電流に対応できることから電子機器や自動車、発電所などあらゆる分野で欠かせない存在となっています。

次世代型に期待される効果



※上記はGaNを使用したパワー半導体の性能を記載
(出所)一般社団法人 GaNコンソーシアムのホームページ、各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

注目のポイント　02

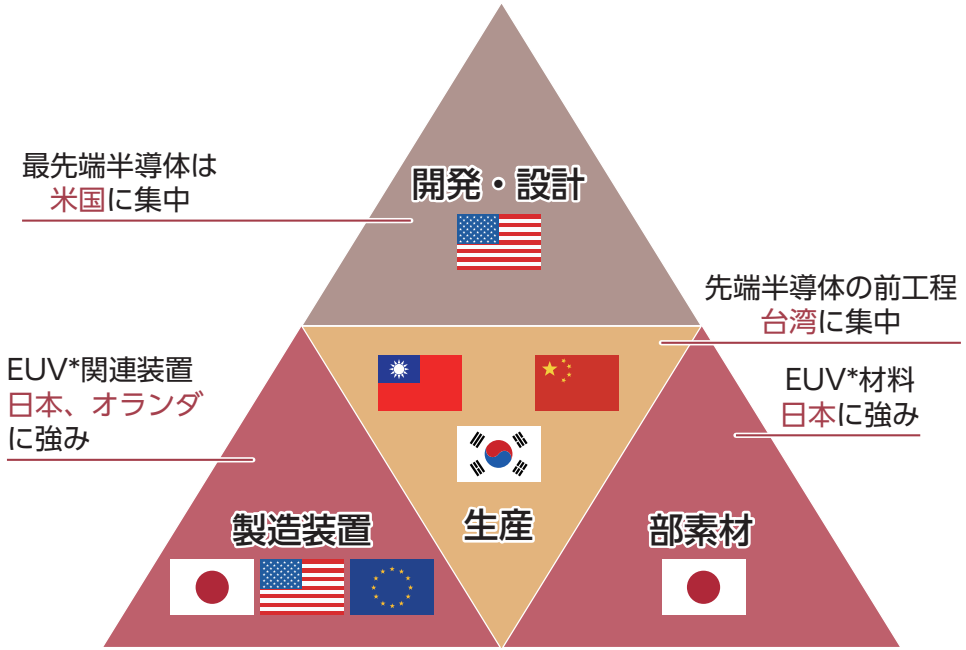
サプライチェーン断絶危機により自国回帰へ

- 半導体は幅広い分野で応用され、技術進化のペースも早いことから、生産には継続的に巨額の投資が必要となります。そのため、開発・設計と生産を別の企業が担い、それぞれの強みに特化する国際的な分業体制が敷かれています。
- 経済安全保障の観点から、先端半導体の生産がアジアに偏在していることを解消するため、主要国・地域は官民挙げて半導体の自国内・域内調達による安定化に舵を切っています。

半導体産業の構造

半導体はそれぞれの国・地域によって**得意な分野が異なる**

日本は開発・設計や生産の企業に製品を供給する分野に強み



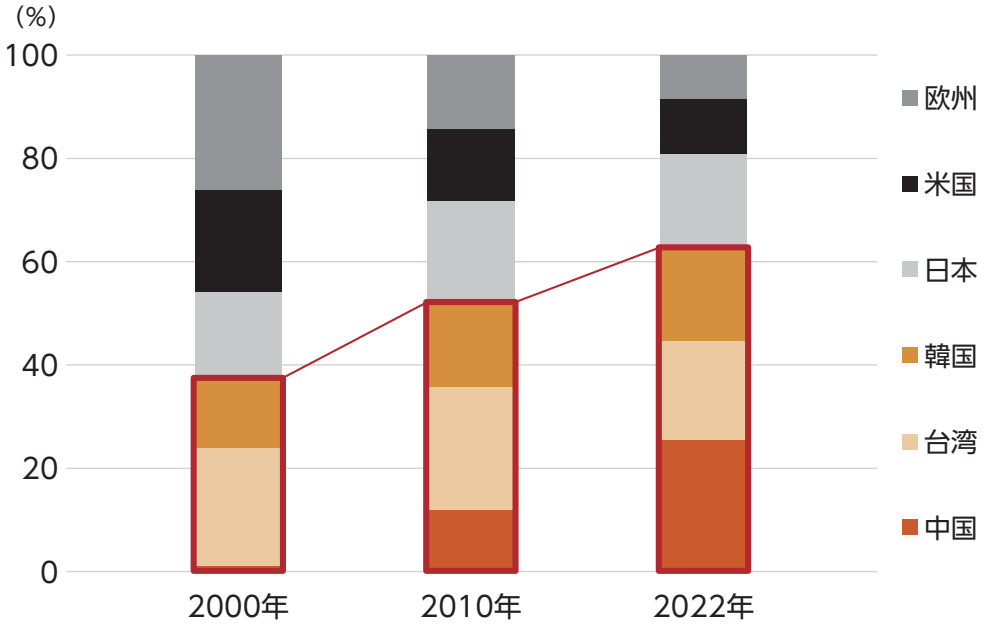
*極端紫外線

※上記は半導体産業の構造の概観図であり、全ての特徴を網羅したものではありません。

主要国・地域の半導体生産能力

目下、半導体の生産能力は**中国・台湾・韓国**に依存

米中分断の深刻化による地政学リスクが高まる



※上記は300ミリウエハー換算値（月間ウエハー投入枚数5千枚以下、または200ミリウエハー未満の製造能力は除く）で、商業用途向け半導体の主要国・地域での製造能力シェア。

（出所）SIA（米国半導体工業会）/BCG（ボストンコンサルティンググループ）「EMERGING RESILIENCE IN THE SEMICONDUCTOR SUPPLY CHAIN」を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

注目のポイント　03

国内の半導体生産強化に向けた政府支援が加速

- 日本政府は半導体戦略の柱に国内の生産能力強化を据えており、先端半導体の製造拠点整備に対する大型支援策を打ち出すなど、官民挙げた投資が拡大しています。
- 現在急ピッチで建設が進む製造拠点の稼働により、今後最大で9.2兆円の経済波及効果が生まれるとの試算*もあるなど、関連企業への恩恵が期待されます。

日本政府の主な政策支援

大型投資

「AI・半導体産業基盤強化フレーム」に基づき、AI・半導体分野に対して、2030年度までに**10兆円超**の公的支援を行う方針

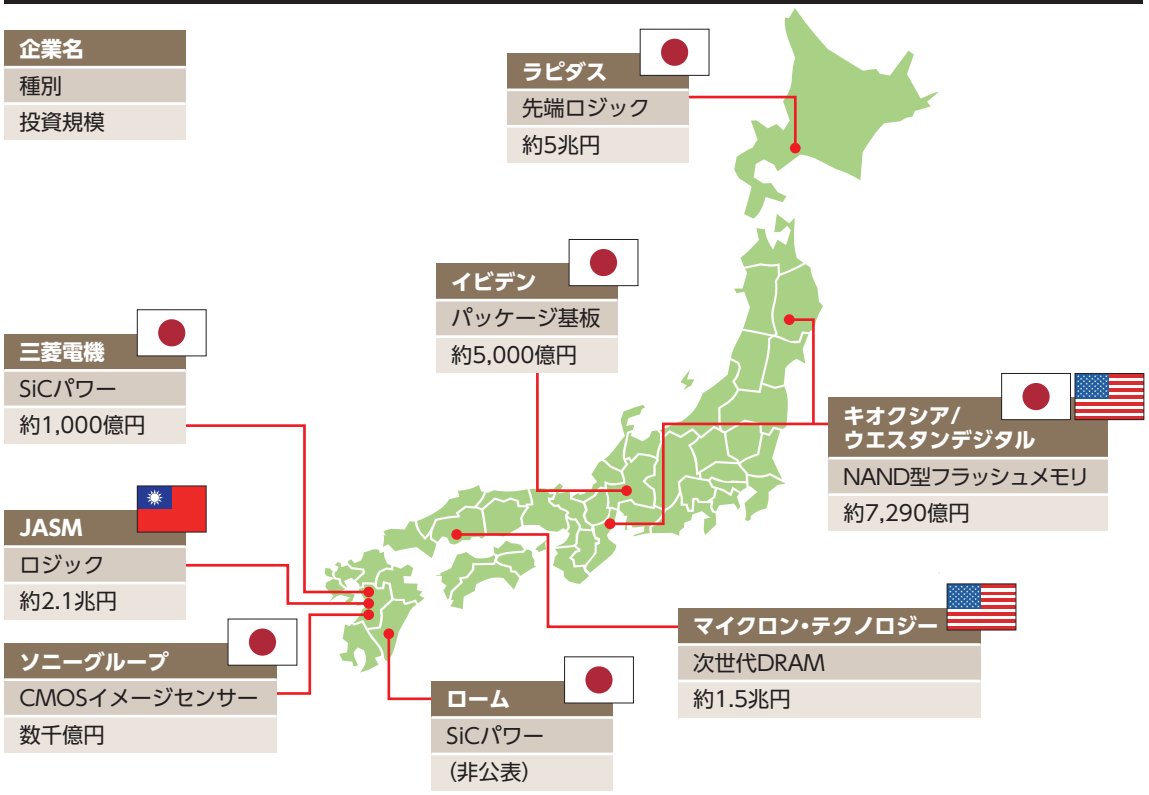
生産売上高目標の設定

国内半導体生産売上高を2030年に**15兆円超に拡大**させる方針（2020年比で**約3倍**、世界半導体市場を上回る成長ペースを目標）

半導体サプライチェーンの強化

「Rapidus（ラピダス）」の支援など、国策として**先端半導体の国産化**を目指す

国内で予定されている主な半導体工場の投資計画



*熊本県のJASMと三重県のキオクシアの先端半導体製造拠点整備に係る産業連関分析結果に基づく
※半導体工場の投資計画は、計画中や投資予定、稼働予定、整備予定も含む。企業名は一部略称で表記。また、当資料作成時点の情報であり、今後変更となる場合があります。
※ラピダスはトヨタ自動車やソニーグループなど国内8社の合弁会社（米IBMと戦略的パートナーシップを締結）。JASMはファウンドリー大手の台湾セミコンダクター（TSMC、台湾）の子会社
（出所）経済産業省、各種資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。

半導体関連
日本株式戦略ファンド
愛称:半導体ジャパン



当ファンドの特徴

1. 半導体産業の高度化において技術貢献力が高く、同産業の成長により業績拡大が期待できる銘柄を厳選します。

2. 半導体産業のサプライチェーンに着目し、日本企業が強みを有する領域とその成長機会にフォーカスした運用を行います。

投資のポイント　01

国内半導体関連企業の高い市場占有率

■ 複雑な半導体生産工程においては高度な技術力が求められるなか、日本企業が高い市場占有率を誇る領域が多数あります。
特に、前工程に使われる部素材の多くで日本企業の占有率が高く、製造装置とともに世界市場で強力な存在感を示しています。

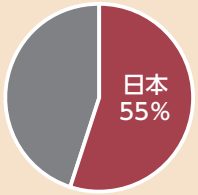
半導体IC（集積回路）チップの生産工程と日本企業の市場占有率

前工程　シリコンウエハーに回路を形成

シリコンウエハー製造
半導体の回路を焼き付ける円盤部材を作る



部素材
シリコンウエハー



フォトマスク作成
ガラス板「マスクブランクス」に電子ビームで回路を描き原板を作る



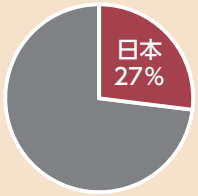
部素材
EUV用マスクブランクス



成膜形成
ウエハー上に絶縁体、金属などの薄い膜を作る



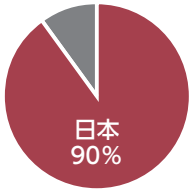
製造装置
CVD/ALD装置（成膜装置）



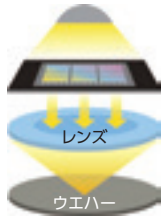
① 感光性材料を塗布
フォトマスクの回路パターンを焼き付けるためのフォトレジスト（感光性材料）をウエハーの表面に塗布



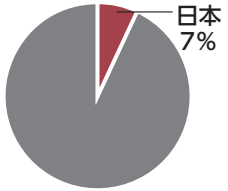
部素材
フォトレジスト



② ウエハー表面に回路を形成
ウエハーの表面にレンズで回路を極小に焼きつける



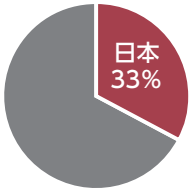
製造装置
露光装置



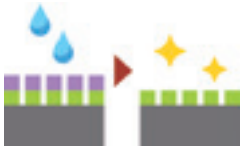
③ エッチング（ウエハー表面加工）
ガスや薬品を使って不要な酸化膜を除去



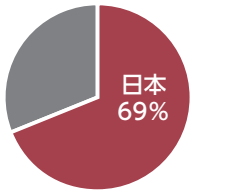
製造装置
エッチング装置



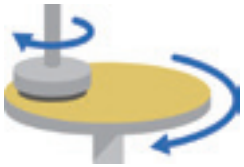
④ レジスト剥離・洗浄
残っているレジストを剥離して不純物を薬液で除去する



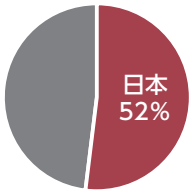
製造装置
洗浄装置（枚葉式）*1



⑤ 平坦化
ウエハーの表面を研磨する



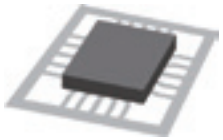
部素材
CMPスラリー（研磨剤）



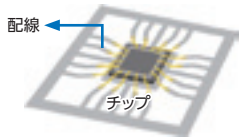
①～⑤を繰り返し、回路を積み上げていく

後工程　検査、チップへの組み立てを経て出荷

9 モールド（封入）
キズや衝撃を抑えるためにセラミックやモールド樹脂でパッケージ



8 ワイヤーボンディング
チップとフレームをワイヤーで結ぶ



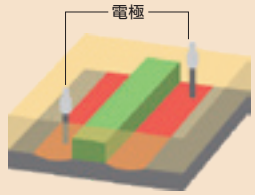
7 マウンティング
チップが所定の位置からズレないように固定



6 ダイシング（切削加工）
ウエハーを切断し仕上がりをチェックし、良品だけを選定



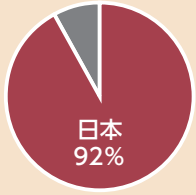
電極形成
電極を配線するための金属をウエハーに埋め込む



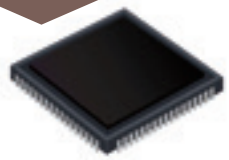
ウエハー検査
ウエハー上のチップそれぞれに対して針を接触させ、通電するか検査する



製造装置
ウエハープローバ*2



半導体部品が完成



*1:ウエハーを1枚ずつ処理する洗浄方法
*2:ウエハーを搬送しデバイス上の決められた位置に針状の電極を当てるために使用する装置
※日本企業の市場占有率の時点は以下の通り。(2020年)CVD/ALD装置、エッチング装置、ウエハープローバ、(2021年)フォトレジスト、露光装置、(2022年)シリコンウエハー、CMPスラリー、洗浄装置、(2024年)EUV用マスクブランクス
(出所) EUV用マスクブランクス、フォトレジスト:各種資料および各社のIR資料、シリコンウエハー、CMPスラリー、洗浄装置(枚葉式):NEDO 2023年度調査報告書「2023年度 日系企業のモノとITサービス、ソフトウェアの国際競争ポジションに関する情報収集」、その他:経済産業省の資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

主な半導体の部素材・製造装置のトップシェア企業

(2026年現在)

部素材

CPU*3用層間絶縁材(ABF)
味の素　100%

EUV用マスクブランクス
HOYA*4　80%

製造装置

コータデベロッパ(感光性材料の塗布現像装置)
東京エレクトロン*5　91%

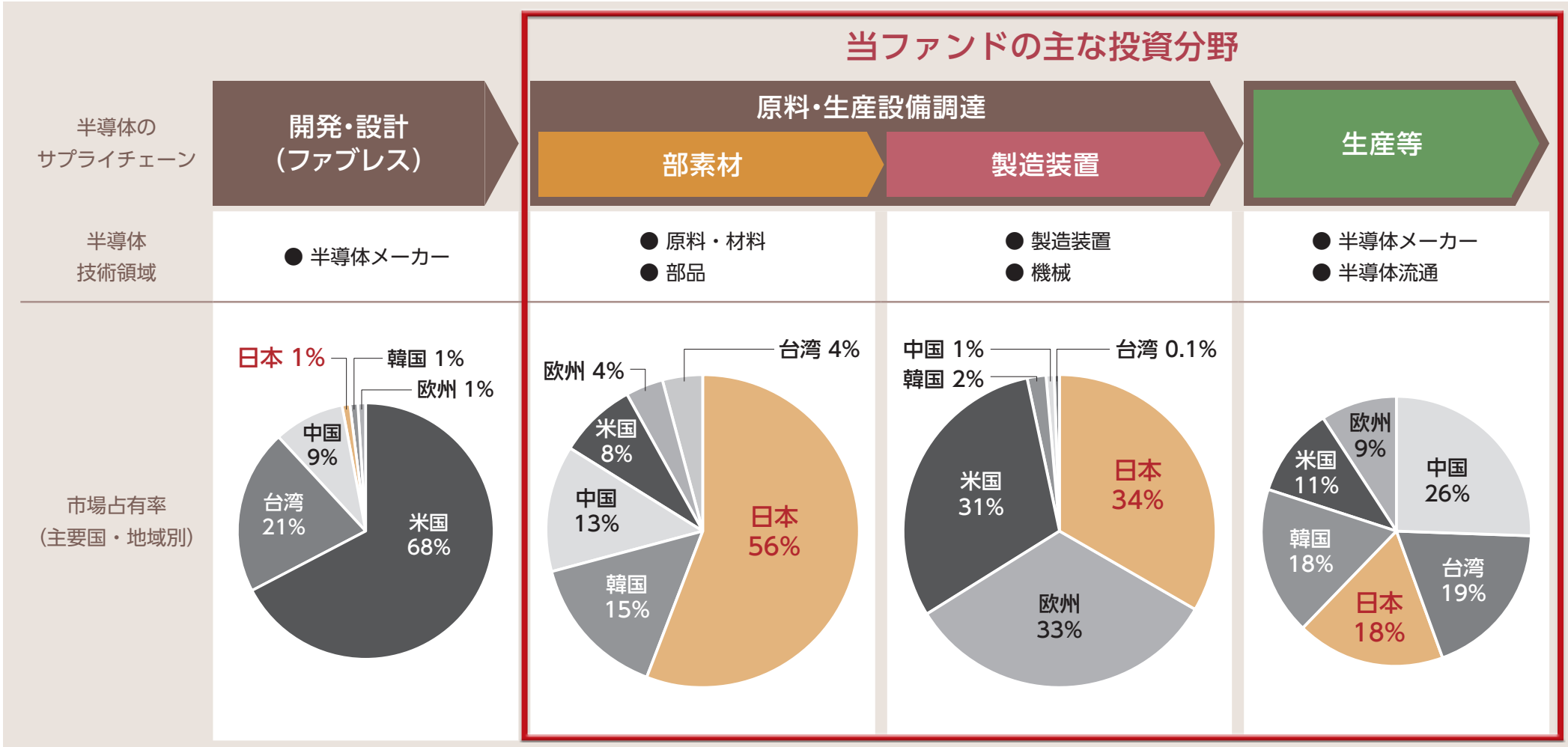
ダイシングソー(ウエハー切断装置)
ディスコ　80%

*3:中央処理装置
*4:2022年現在
*5:2025年現在
(出所)各種資料、各社のIR資料を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※上記はイメージ図であり、半導体ICチップの生産工程の全てを表したものではありません。また、特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。

当ファンドが着目する半導体関連分野

■ 半導体生産において、日本はとりわけ部素材と製造装置の分野で市場占有率が高く、原料・生産設備調達の工程で大きな存在感を示しています。当ファンドは国内半導体関連企業の強みである分野に着目し、投資銘柄を厳選します。



※市場占有率について、時点は以下の通り。開発・設計:2021年、部素材、製造装置、生産等:2022年。生産等の比率は8ページの「主要国・地域の半導体生産能力」の注記をご覧ください。また、各比率は端数処理の関係で合計値が100%とならない場合があります。

(出所) 開発・設計:Statista、部素材および製造装置:NEDO 2023年度調査報告書「2023年度 日系企業のモノとITサービス、ソフトウェアの国際競争ポジションに関する情報収集」、生産等:SIA/BCG「EMERGING RESILIENCE IN THE SEMICONDUCTOR SUPPLY CHAIN」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※上記は現時点で当ファンドが着目する半導体関連分野であり、今後変更となる場合があります。

半導体関連企業のご紹介　01

KOKUSAI ELECTRIC

半導体製造の前工程の一つ「成膜」技術に強みを有する

<事業内容>

- 半導体製造装置メーカーであり、半導体製造プロセスの「成膜」工程で用いられる製造装置において高い競争力を有する。

半導体技術領域	製造装置
時価総額	約1.8兆円

<着目ポイント>

- 半導体デバイスの性能を左右する成膜プロセス、トリートメント（膜質改善）プロセス装置において強みを有し、難度が高い3D NAND（メモリセルを垂直に積層することで記憶容量を増大させるフラッシュメモリ技術）の成膜プロセスで高い実績を有する。
- DRAMやロジック半導体においても三次元化が進み、デバイスがより複雑な段差構造になることが見込まれる中、同社の製造装置に対する需要拡大が期待される。

<株価とEPSの推移>



※2023年10月上場

半導体関連企業のご紹介　02

MARUWA

幅広い分野で需要が高まるセラミック基板に強み

<事業内容>

- セラミック材料技術を中核に、車載・情報通信・半導体・産業機器などの幅広い事業分野に対して材料や部品を供給。

半導体技術領域	部素材
時価総額	約6,871億円

<着目ポイント>

- 同社は、セラミック基板の中でも優れた放熱性を持つ高熱伝導基板において世界トップクラスのシェアを有する。
- 高熱伝導基板は、EVやハイブリッド車のパワー半導体に代表されるような大量に熱が発生する電子部品において欠かせない製品であり、半導体高度化を根幹から支える役割を担う。

<株価とEPSの推移>



※時価総額:2026年7月末現在。株価（日次）とEPS（年次）の推移:2023年7月末～2026年7月末（KOKUSAI ELECTRICの株価は2023年10月25日～2026年7月末）。EPS予測値:2027年～2029年（年次）、当資料作成時点のBloomberg予測値（会計年次ベース）。
（出所）各種資料、Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

半導体関連企業のご紹介　03

信越化学工業

半導体材料から製造プロセスまで支える大手化学メーカー

<事業内容>

- 半導体製造向けを主力とする電子材料事業のほか、生活環境基盤材料や機能材料などの事業を手掛け、幅広い素材技術を有する化学メーカー。

半導体技術領域	部素材
時価総額	約11.5兆円

<着目ポイント>

- 高シェアを有するシリコンウエハーを筆頭に、半導体製造工程に使用されるフォトレジスト、マスクブランクス、封止材料などを手掛ける。
- 半導体市場の拡大に応じた需要拡大が見込めるだけでなく、AI半導体など最先端のニーズに対応する幅広い材料を提供するとともに、新規材料の開発を通じて、半導体の高効率化に貢献している。

<株価とEPSの推移>



半導体関連企業のご紹介　04

ソニーグループ

多角化戦略で前進するグローバル企業

<事業内容>

- 電気機器やエンタメ関連事業など多角的に事業を展開。半導体関連事業では、イメージセンサー分野において高い技術力を有する。

半導体技術領域	生産等
時価総額	約22.6兆円

<着目ポイント>

- スマートフォンやデジタルカメラ、自動車、セキュリティカメラなど、世界中の様々な分野で使われるイメージセンサーで、世界トップクラスのシェアを確立。
- スマートフォンの高機能化に伴いイメージセンサーの付加価値が高まるほか、中長期的にはモバイルセンシング市場の拡大が期待される。

<株価とEPSの推移>

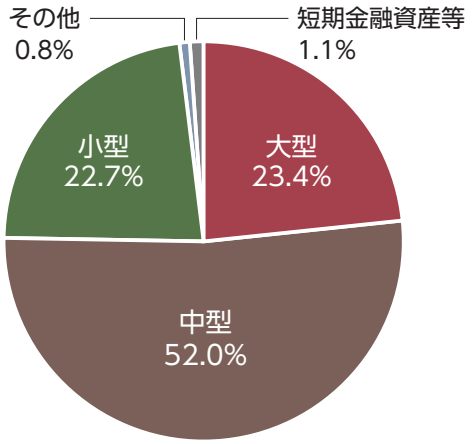


※時価総額:2026年7月末現在。株価(日次)とEPS(年次)の推移:2023年7月末～2026年7月末。EPS予測値:2027年～2029年(年次)、当資料作成時点のBloomberg予測値(会計年次ベース)。
(出所)各種資料、Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

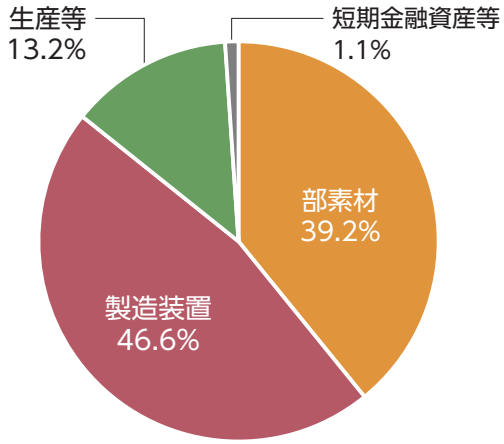
※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

マザーファンドの概要（2026年7月末現在）

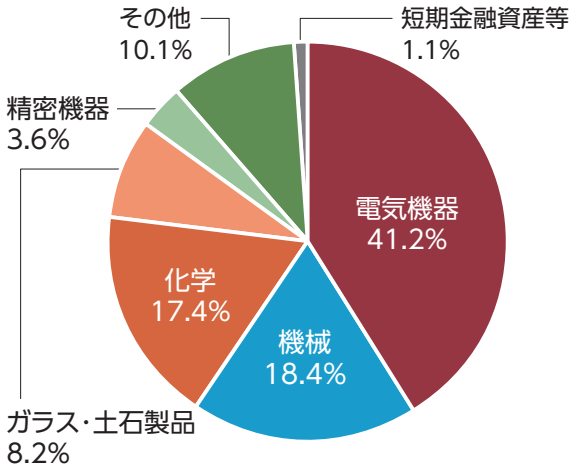
■規模別構成比率



■半導体技術領域別構成比率



■業種別構成比率



■組入上位10銘柄

組入銘柄数 :43 銘柄

	銘柄名	構成比率	半導体技術領域	事業内容
1	東京エレクトロン	5.1%	製造装置	世界大手の一角を担う半導体製造装置メーカー
2	KOKUSAI ELECTRIC	4.3%	製造装置	半導体デバイス製造の前工程における成膜に特化した半導体製造装置メーカー
3	SCREENホールディングス	4.2%	製造装置	半導体デバイス製造で不可欠な洗浄装置を製造
4	MARUWA	4.0%	部素材	電子部品用セラミックスやコンデンサー、混成ICを製造・販売
5	イビデン	4.0%	部素材	プリント配線板、特殊炭素、ICパッケージなど電子機器を製造・販売
6	荏原製作所	3.7%	製造装置	半導体の製造工程で使用されるドライ真空ポンプや排ガス処理装置などを製造・販売
7	アドバンテスト	3.7%	製造装置	半導体デバイスのテスト装置や電子計測機器などを製造
8	ダイフク	3.5%	製造装置	半導体製造で不可欠なクリーンルーム向けシステムを世界で提供
9	ディスコ	3.5%	製造装置	研削切断装置や精密加工機械を製造。半導体切断装置などで高シェア製品を有する
10	東京応化工業	3.5%	部素材	半導体用フォトレジストで世界トップクラスのシェアを誇る大手メーカー

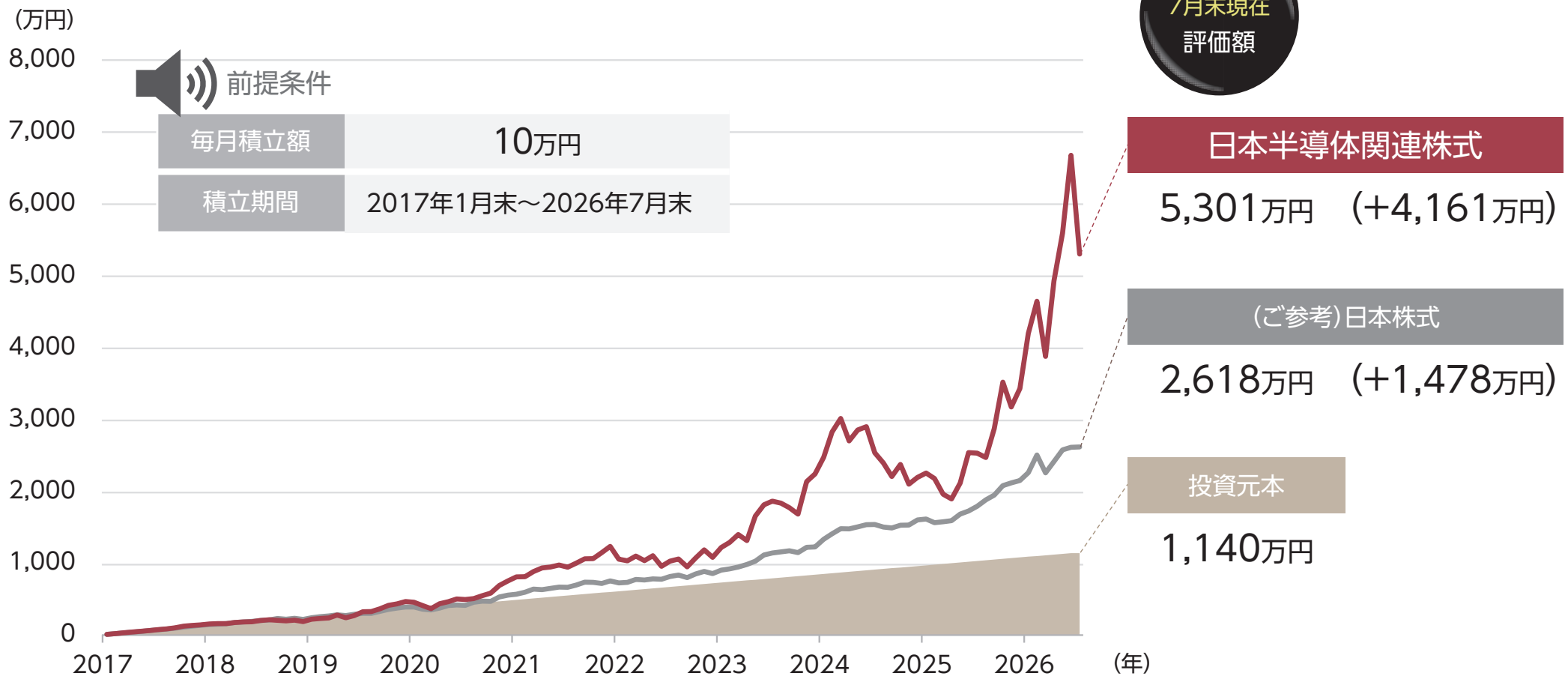
※規模別構成比率は東証規模別株価指数による分類（TOPIX構成銘柄以外についてはその他に分類）、半導体技術領域別構成比率は三井住友トラスト・アセットマネジメントの分類定義によるものです。
※各構成比率は対純資産総額比、端数処理の関係で合計値が100%とならない場合があります。
※上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありません。また、今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

ご参考

長期的な成長テーマを「積立投資」で捉える

- 長期的な成長テーマを資産の成長につなげるためには、長期目線で投資に臨むことが重要です。
- 特に投資タイミングに悩む場合には、「積立投資」を活用し時間を分散しながら、長期目線で投資を続けることも選択肢のひとつです。

毎月10万円ずつ積立投資した場合の評価額の推移



※次のインデックス(配当込み)を使用。日本半導体関連株式:ファクトセット日本半導体インデックス、日本株式:TOPIX
※積立投資の期間は2017年1月末から開始、2026年7月末に終了するものとし、積立投資の評価金額は各インデックスの各月末の値を使用して算出。また、積立期間の最終月の積立元本は、運用収益算出の都合上、加算せずに算出
(出所)Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※上記は所定の前提条件を基に行ったシミュレーションであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、購入時における手数料、税金等の諸費用は考慮しておりません。

当ファンドの運用体制

- 半導体産業のサイクルや技術開発動向、競争環境などに精通した運用プロフェッショナルが、徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、厳選投資を実施します。
- 具体的には、日本半導体関連企業の①世界における立ち位置、②競争環境、③成長フェーズを踏まえた上で、半導体産業において勝ち組となりうる銘柄を選定します。

マザーファンドの運用プロセス

日本の株式

日本の全上場企業の中から、時価総額等を勘案した上で、半導体関連企業の株式を選定

投資候補銘柄群

- 個別企業のファンダメンタルズ分析（財務分析、企業経営陣との面談、技術動向調査等）を通じて、企業の成長性や株価の割安度を検証し、銘柄を選定
- 流動性を考慮してポートフォリオを構築

ポートフォリオ

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

日本株式運用体制

国内株式運用チーム

●在籍者数	●平均運用経験年数
10名	19年6カ月

リサーチ内容を共有

企業リサーチユニット

●在籍者数	●平均リサーチ経験年数
22名	13年5カ月

- □ 企業訪問などのリサーチ件数 年間8,010件
- □ 企業経営陣取材件数 年間約800件

網羅的なリサーチ活動により約800社（東証プライム上場企業の90%超*）をカバー

*時価総額ベース
※在籍者数と各平均経験年数は2026年7月末現在、リサーチ件数および取材件数は2025年度実績

※資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、上記の運用ができない場合があります。

ファンドの特色





日本の半導体関連企業の株式に投資を行います。

- 「半導体関連　日本株式戦略マザーファンド」への投資を通じて、主として日本の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業の株式に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

半導体関連企業とは	当ファンドにおいては、半導体および半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいいます。



半導体関連企業を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築します。

※資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、上記の運用ができない場合があります。

ファンドの投資リスク

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

株価変動リスク	株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
信用リスク	有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
特定の業種に特化した運用に係るリスク	ファンドは、特定の業種に関連する企業の株式を選別して組み入れますので、市場全体の値動きと比較して、基準価額の変動が大きくなる可能性があります。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

お申込みメモ・ファンドの費用

お申込みメモ

信託期間	無期限（2024年1月29日設定）
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回、毎決算時に分配金額を決定します。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
購入単位	販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額とします。
換金単位	販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	換金申込受付日の基準価額とします。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として、販売会社の営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※上記は、2026年8月31日現在のものです。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。

ファンドの費用

▼お客様が直接的にご負担いただく費用

購入時手数料	購入価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。 **（上限3.3%（税抜3.0%））**
信託財産留保額	**ありません。**

▼お客様が間接的にご負担いただく費用

運用管理費用（信託報酬）	純資産総額に対して**年率1.562%（税抜1.42%）** <運用管理費用の配分と主な役務> 委託会社　年率0.759%（税抜0.69%） ◇委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 販売会社　年率0.759%（税抜0.69%） ◇運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社　年率0.044%（税抜0.04%） ◇運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
その他の費用・手数料	有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度、監査費用等を日々、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社およびファンドの関係法人

■ **委託会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社** [ファンドの運用の指図]
ホームページアドレス https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル 0120-668001 (受付時間:営業日の午前9時～午後5時)

■ **受託会社:三井住友信託銀行株式会社** [ファンドの財産の保管および管理]

■ **販売会社:当ファンドの販売会社については委託会社にお問い合わせください。**
[募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付等]

SMTAM投信関連情報サービス

お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。

※LINEご利用設定は、お客様のご判断でお願いします。
※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

【 ご留意事項 】

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。


三井住友トラスト・アセットマネジメント